

证券代码：688535

证券简称：华海诚科

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	☒特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☒现场参观 ☐电话会议 ☐其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	国金证券
会议时间	2024 年 2 月 23 日 14：00-16：00
会议地点	现场
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：董东峰 证券事务代表：钱云 证券事务专员：张雅婷
投资者关系活动主要内容介绍	问题一：请问贵公司产品是 SRAM 和 HBM 生产中的必须品吗？ 回复：公司主要产品包括环氧塑封料与电子胶黏剂，广泛应用于半导体封装、板级组装等应用场景。静态随机存储器芯片与高带宽存储器芯片在封装环节也会用到环氧模塑料。 问题二：请问贵司是否和盛合晶微有合作？目前先进封装材料验证情况如何？哪些已经开始量产？ 回复：公司和盛合晶微没有合作。先进封装用材料型号较多公司已与多家客户开展验证或批量交付，具体情况请参考公司招股书及定期报告。 问题三：公司整体的业务进展如何？ 回复：公司立足于传统封装领域逐步扩大市场份额，并积极布局

	先进封装领域，推动高端产品的产业化。在传统封装领域，公司应用于 SOT、SOP 领域的产品的市场份额逐步提升。在先进封装领域，公司应用于 QFN 的产品 700 系列产品已实现小批量生产与销售；同时，公司紧跟先进封装未来发展趋势，布局晶圆级封装与系统级封装，在上述领域的产品布局逐步完善，应用于 FC、SiP、FOWLP/FOPLP 等先进封装领域的相关产品正逐步通过客户的考核验证，有望逐步实现产业化。 问题四：请问 FOWLP 和 FOPLP 具体区别是什么？ 回复：扇出型晶圆封装（FOWLP）对晶圆级封装（WLP）的改进，可以为硅片提供更多外部连接。它将芯片嵌入塑封材料中，然后在晶圆表面构建高密度重分布层（RDL）并施加焊锡球，形成重构晶圆；扇出型板级封装（FOPLP）是将芯片再分布在矩形载板上，然后采用扇出（Fan-out）工艺进行封装。FOPLP 技术重点之一为同质、异质多芯片整合，这些芯片通过微细铜重布线路层(RDL)连结的方式整合在单一封装体中，甚至将整个系统所需的功能芯片一次打包成为单一组件，整合在一个封装体中。FOPLP 封装方法与 FOWLP 类似，且在同一工艺流程中可生产出更多的单个封装体，具有更好的材料利用率和更低成本。 问题五：请问公司高端环氧塑封料产品实现国产化替代的情况？ 回复：高端塑封料的技术突破到小批量出货到真正的批量需要相当长的时间，现阶段在高端塑封料领域外资仍处于主导地位，即便有部分高端塑封料实现了量产出货，但是进口替代仍然需要凭借不懈的技术开拓、稳定的产品质量、完善及时的客户服务逐步推进。 注：本次活动不涉及应当披露重大信息的特别说明，其他相关介绍、交流情况可参阅近期《投资者关系活动记录表》之内容和已对外披露正式公告。
附件清单（如有）	无

日期	2024 年 2 月 23 日
----	-----------------